

SDIOインタフェース Wi-Fi 6/6E (2.4/5/6GHz) & Bluetooth® 低消費電力無線LANコンボモジュール SX-SDMAX6E



バッテリー駆動機器の無線化課題「省電力化」と「安定通信」を同時に解決

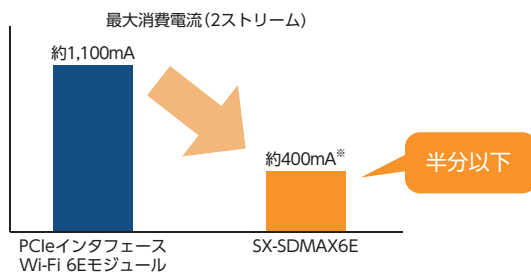
概要

本製品はNXP社製IW623チップセットを採用し、SDIOインタフェースの省電力性と6GHz帯による次世代の安定通信を実現する組み込み無線LANモジュールです。2ストリームモードによる高速通信は画像や映像などの無線通信をより快適にし、省電力な1ストリームモードと使い分けることで多様なバッテリー駆動機器の無線化を実現します。

SX-SDMAX6Eが無線化開発の「こうしたい!」を実現します

💡 バッテリー駆動の機器でWi-Fi6/6Eに対応したい

💡 映像や画像も“省電力で”通信したい



- ✓ 低消費電力SDIOインタフェースに対応
- ✓ バッテリー駆動の機器に最適

- ✓ 高速通信の2ストリームモード対応
- ✓ 省電力な1ストリームモードと使い分けることで電力効率を改善

💡 無線機器が多い現場でも安定通信したい

💡 移動中でも常に通信を安定させたい



- ✓ 2.4、5GHz帯電波と干渉しない6GHz帯対応
- ✓ IEEE 802.11k/v/r高速ローミングで移動時も通信経路を安定切り替え
- ✓ 大切なデータの安定通信

💡 Wi-FiとBluetooth®を同時に使用したい

Wi-Fi 6/6E

Bluetooth®



- ✓ 専用アンテナ設計でWi-Fiとの完全な同時通信を実現
- ✓ ひとつのモジュールで対応でき、設計を簡素化

Bluetooth®
専用アンテナ



製品仕様

型番	SX-SDMAX6E-2530S SX-SDMAX6E-M2
チップセット	IW623
ホストインタフェース	無線LAN: SDIO3.0 Bluetooth®: UART
無線LAN仕様	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (1x1 or 2x2)
周波数帯	2.4GHz, 5GHz, 6GHz
帯域幅	[2.4GHz] 20MHz/40MHz [5GHz] 20MHz/40MHz/80MHz [6GHz] 20MHz/40MHz/80MHz
Bluetooth®仕様	Bluetooth® v5.4
アンテナ端子	[SX-SDMAX6E-2530S] RF PAD [SX-SDMAX6E-M2] MHF1コネクタ3個
動作電圧	[SX-SDMAX6E-2530S] 主電源: 3.3V, 1.8V IO/SDIO電源: 3.3Vまたは1.8V [SX-SDMAX6E-M2] 主電源: 3.3V
動作環境条件	温度条件: -40 ~ +85℃ 湿度条件: 15 ~ 80%RH (結露なきこと)
保存環境条件	温度条件: -40 ~ +85℃ 湿度条件: 10 ~ 85%RH (結露なきこと)
外形寸法	[SX-SDMAX6E-2530S] 17.0×18.0×2.65mm [SX-SDMAX6E-M2] 設計中
パッケージタイプ	[SX-SDMAX6E-2530S] 44pins Direct Solder Pads [SX-SDMAX6E-M2] M.2 card type key-E
無線規格対応	日本、アメリカ、カナダ、欧州、イギリス

※ 開発中のため仕様は変更される可能性があります。

製品ラインナップ



SX-SDMAX6E-2530S
(表面実装タイプ)



SX-SDMAX6E-M2
(M.2 コネクタタイプ)

[SX-SDMAX6E 製品紹介ページ]

<https://www.silex.jp/products/wireless-module/sdio/sxsdmax6e>

製品に関するご質問は

弊社カスタマサポートセンターまでお問い合わせください。

【お問い合わせページ】<https://www.silex.jp/contact/contact-input>

国内自社工場で生産する高品質なモジュール

本製品は京都けいはんな本社にて開発・生産を行っています。20年以上産業機器を無線化してきた経験を活かした品質管理により、産業用途でも安心してご利用いただける製品をご提供します。

また、使用部品のEOL (End Of Life) 時にも最終発注と保管によりお客様のご希望に合わせた継続生産に向けて取り組んでいます。



ドライバ移植作業を軽減

サイレックスはNXP Semiconductorsのゴールドパートナーです。

NXP
Gold
Partner

本製品ではIW623チップセットの試作段階から技術連携し、サイレックスで独自に検証・改善を重ねた高品質なドライバソフトウェアをご準備しています。

製品評価時にはリファレンスプラットフォーム用のドライバを無償でご提供し、スムーズに評価開始していただける他、ソフトウェア・ハードウェア・無線認証・生産といった製品開発に必要なサポートをワンストップでご提供します。

製品評価の詳細については、2026年以降情報公開予定です。



- NXPは、NXP B.V.の商標です。
- その他記載された社名及び製品名は各社の登録商標または商標です。

- Bluetoothは、米国Bluetooth SIG, Inc. の商標または登録商標です。
- 改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。記載の仕様は2025年10月現在のものです。